

HPI

Interne TE-Nummer 3-1470108-2

PCB Mount Header, Right Angle, Wire-to-Board, 32 Position, 2 mm
[.079 in] Centerline, Fully Shrouded, Tin, Through Hole - Solder,
Signal, Natural, HPI

[Auf TE.com ansehen>](#)

Steckverbinder > PCB-Steckverbinder > Leiterplattenstiftleisten und -buchsen > AMP HPI 2.0 mm Headers

PCB-Steckverbindermontagetyp: **Stiftleiste für die Leiterplattenmontage**Montageausrichtung für Leiterplatte: **Rechter Winkel**Steckverbindersystem: **Draht-an-Leiterplatte**Anzahl von Positionen: **32**Raster: **2 mm [.079 in]**[Alle AMP HPI 2.0 mm Headers \(220\)](#)**Eigenschaften****Produktmerkmale**

PCB-Steckverbindermontagetyp	Stiftleiste für die Leiterplattenmontage
Steckverbindersystem	Draht-an-Leiterplatte
Stecksockeltyp	Vollständig ummantelt
Abdichtbar	Nein
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Ladungszustand des Steckverbinderkontakts	Voll bestückt
Montageausrichtung für Leiterplatte	Rechter Winkel
Anzahl von Positionen	32
Zeilenanzahl	2

Elektrische Kennwerte

Isolierwiderstand	5000 MΩ
Arbeitsspannung	100 VDC

Sonstige Eigenschaften

Primäre Produktfarbe	Naturbelassen
----------------------	---------------

Kontaktmerkmale

Länge des Steckbereichs des Kontakts	3.5 mm[.138 in]
Abmessungen des Steck-Quadratpfostens	.5 mm[.02 in]
	100 µin
Kontaktform	Quadratisch
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Zinn
Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts	2.54 µm[100 µin]
Kontakttyp	Stift
Kontakt-nennstrom (max.)	3 A

Klemmenmerkmale

Quadratischer Endverschluss, Anschlussstift- und Restabmessungen	.5 mm[.02 in]
Anschlüsse pro Pfosten (max.)	3
Anschlussstift- und Restlänge	3 mm[.118 in]
Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschluss-technik

Typ der Gegensteckführung	Kodiert
Gegensteckführung	Mit
Montageausrichtung der Leiterplatte	Ohne
Gegensteckarretierung	Ohne
Arretierung für Leiterplattenmontage	Ohne
Art der Steckverbinder-montage	Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

Raster	2 mm[.079 in]
Gehäusematerial	Hochtemperatur-Thermoplast

Abmessungen

Leiterplattendicke (empfohlen)	1.57 mm[.062 in]
Reihenabstand	2 mm[.079 in]

Verwendungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	-25 – 85 °C[-13 – 185 °F]
---------------------------	---------------------------

Betrieb/Anwendung

Stromkreis Anwendung	Signal
----------------------	--------

Industriestandards

Zugelassene Standards	CSA LR7189, UL E28476
UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

Verpackungs-Typ	Einzelausführung
-----------------	------------------

Weitere

Ausgelassene Positionen	0
-------------------------	---

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf [TE.com](https://www.te.com) um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JAN 2023 (233) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JAN 2023 (233) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Niedriger Halogengehalt – Br, Cl, F, I < 900 ppm im homogen Material. Außerdem BFR/CFR/PVC-frei.
Lötfähigkeit	Wellenlötfähig bis 240 °C

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den ‚Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen‘, wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: <https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

Kompatible Teile



Auch serienmäßig | HPI



Kunden kauften auch diese Produkte



Dokumente

Produktzeichnungen

[2.0MM PITCH HEADER,DIP 32P](#)

Englisch

CAD-Dateien

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_3-1470108-2_F.2d_dxf.zip](#)

Englisch

[3D PDF](#)

3D

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_3-1470108-2_F.3d_igs.zip](#)

Englisch

Kundenmodell

[ENG_CVM_CVM_3-1470108-2_F.3d_stp.zip](#)

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den [allgemeinen Verkaufsbedingungen](#) zu.

Datenblätter/ Katalogseiten

[AMPMODU_INTERCONNECTION_SYSTEM_SECTION3AND4](#)

Englisch

[HPI Connectors QRG](#)

Englisch

Produktspezifikationen

[AMP 2.0mm PITCH EMIX Economic Metric Interconnect Series, Wire-To-Board System.](#)

Englisch

[Anwendungsspezifikation](#)

Englisch